



Q1. 中美矽晶 2026 年第二季整體營運表現及未來展望？

A：

2026 年第二季中美矽晶合併營收 211.2 億元，年增 4.4%，創歷年同期新高；稅後淨利 44.5 億元，達歷年同期次高，EPS 3.19 元，整體獲利表現穩健。上半年累計營收 405 億元，年增 2.3%，亦創歷年同期次高，顯示本業動能持續穩定。

展望未來，公司過去在半導體、再生能源及車用電子三大事業的布局已逐步開始發酵，隨 AI 應用擴張、全球能源轉型加速及供應鏈重組趨勢深化，相關需求可望持續轉化為實質成長動能。公司亦將持續優化產品組合與高附加價值布局，強化集團長期競爭力與獲利韌性。

Q2. 公司再生能源事業目前布局及未來成長動能如何？

A：

在全球能源轉型及 AI 用電需求持續成長下，中美矽晶持續深化再生能源「製造 + 服務」雙軌布局。

製造方面，公司持續深耕國內屋頂型太陽能市場，並聚焦高品質、高可靠度及高附加價值產品，防火型模組已量產出貨。同時，隨全球供應鏈重組，市場對低碳製造、產品可追溯性及合規供應鏈的重視持續提升，公司亦積極拓展低軌衛星、零能耗建築等新興應用。其中，太空用 PERC 太陽能電池已由宜蘭廠量產出貨，供應多家美國客戶；未來隨市場需求及訂單能見度提升，亦具備進一步擴充產能的彈性。

服務方面，續升綠能持續發展創能、售能、儲能及節能一站式能源服務。目前已簽署合約規模逾新台幣 1,000 億元，其中逾 85% 為 10 年以上長期合約。未來隨 CIP 風妙一期離岸風電加入供電組合，將進一步透過「風光互補」提升綠電供應穩定性，持續掌握企業能源轉型需求。

Q3. 子公司續升綠能登錄興櫃後，下一階段的主要成長動能為何？

A：

續升綠能 (7931) 於 2026 年 6 月登錄興櫃，是公司發展的重要里程碑。下一階段將從綠電資源與長期合約的持續累積，逐步進入轉供規模擴大與營運成果實現階段。隨既有長期 CPPA 陸續進入轉供，長期合約將逐步轉化為穩定的營收與現金流，提升營運能見度。

同時，續升將持續擴充多元再生能源來源，未來隨離岸風電陸續併網，透過「風光互補」提升供電穩定性與韌性；服務面亦將從綠電供應進一步延伸至儲能、節能及智慧能源管理，持續深化一站式能源

服務平台，提升客戶黏著度與長期成長動能。

Q4. 公司如何看待再生能源事業未來展望？

A：

隨 AI 資料中心、高科技製造及電氣化快速發展，全球電力需求持續攀升，能源的重要性正從過去的營運成本，逐步轉變為影響企業產能布局、供應鏈韌性與長期競爭力的戰略資源。尤其對半導體及高科技產業而言，能否取得穩定、具競爭力且符合減碳要求的電力，將成為企業持續成長的重要基礎。

另一方面，能源自主與全球供應鏈重組也正改變再生能源產業的競爭模式，市場除關注成本與效率外，對在地製造、低碳製造、產品可追溯性及合規供應鏈的要求持續提升；同時，企業對能源的需求亦從單純採購綠電，逐步延伸至供電穩定性、能源效率及智慧能源管理。

在此趨勢下，公司看好再生能源製造與能源服務的長期發展機會，並將持續發揮雙軌布局優勢，掌握 AI 用電成長、能源自主及全球淨零轉型帶來的市場機會。

Q5. 面對 AI、能源轉型及新興科技快速發展，中美矽晶如何掌握未來成長機會？

A：

AI 資料中心、電氣化及產業發展正同步推升全球算力與電力需求，帶動半導體、再生能源及電力基礎建設長期成長。同時，低軌衛星及高速通訊亦進入快速發展階段，進一步帶動太空級太陽能產品、光通訊元件及先進半導體技術需求。

面對上述趨勢，中美矽晶已建立涵蓋半導體、再生能源及汽車元件的多元事業布局，並透過環球晶圓、續日、續升綠能及各關聯企業的技術與資源整合，掌握 AI「算力 + 電力」、能源轉型及新興科技應用帶來的市場機會，持續強化集團長期成長動能。

Q6. 公司如何看待子公司環球晶圓及關聯企業下半年整體展望？

A：

環球晶圓受惠 AI、高效能運算及先進製程需求持續成長，以及工業與電源管理等應用逐步回溫，半導體市場復甦動能持續擴散。目前既有 12 吋晶圓產線維持滿載，8 吋稼動率維持高檔，復甦動能亦逐步延伸至 6 吋產品；隨美國、義大利及日本等新產能陸續完成客戶認證並投入量產，加上 SOI、GaN、12 吋 SiC 及先進封裝相關材料等高附加價值產品布局，將持續強化長期成長動能。

台特化受惠先進製程擴產及 AI 需求，高階特氣與半導體前驅物需求持續成長，下半年產能利用率預期接近滿載。矽乙烷與 AHF 出貨持續提升，並同步推進產能擴充計畫。此外，透過收購弘潔科技，台特化進一步將服務範疇拓展至半導體設備零件清洗與鍍膜服務，不僅提升對既有客戶的服務價值，也為整體業務成長注入持續動能。

宏捷科受惠 Android 旗艦機及中高階手機需求，並持續拓展無人機 WiFi 與高速光通訊等新興應用。隨 AI 資料中心及高速光通訊需求成長，作為核心關鍵元件的發射光源 LD 與光偵測器 PD，市場需求持續提升。目前部分產品已進入客戶送樣驗證階段，並與多家國際客戶持續推進合作專案，可望成為未來新的成長動能。

朋程核心車用市場需求維持穩健，並持續開發 SiC 功率模組、SiC 智慧功率模組 (IPM) 及高壓半導體等新產品。隨全球 Tier-1 車用及工業客戶 Design-In 與 Design-Win 專案持續累積，公司亦積極拓展 AI 資料中心、伺服器電源、儲能及固態變壓器 (SST) 等高成長應用，持續強化車用與工業雙軌布局。

整體而言，集團各事業既有核心業務維持穩健，並持續透過全球產能布局、產能擴充、新產品開發及新興應用拓展，掌握 AI、先進製程及能源轉型帶來的市場機會；同時，集團內部亦透過客戶資源整合與供應鏈整合，發揮跨事業綜效，進一步強化整體營運效率與長期成長動能，持續打造多元且具韌性的成長基礎。